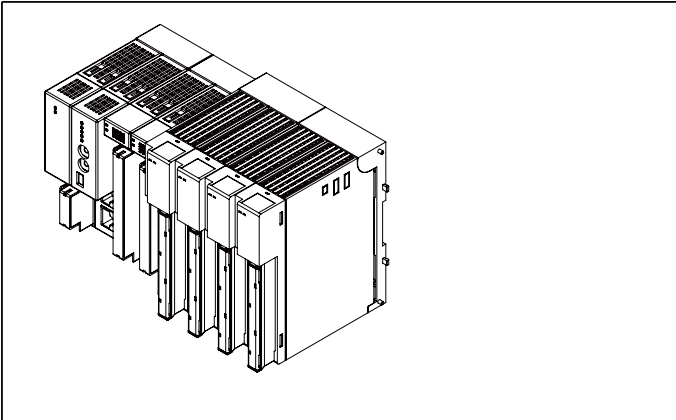


## 遠端 I/O R30 系列

### 安裝基座 (增設 R3 輸出入模組用)



### 型號: R30EBS[1][2]

#### 訂購時指定事項

- 代碼: R30EBS[1][2]  
參考下面 [1] 到 [2] 說明並指定各項代碼。  
(例如: R30EBS08/Q)
- 指定選項代碼/Q 的規格  
(例如: /C01)

#### [1] I/O槽位數量

- 04: 4 槽
- 08: 8 槽

#### [2] 選項

- 空白: 無
- /Q: 有選項 (需指定選項規格)

#### 選項規格 : Q

塗層 (有關詳細訊息, 請參考 M-System 的網站。)

只有基板的焊接面有塗層。

模組安裝面沒有塗層。

/C01: 矽膠塗層

/C02: 聚氨酯塗層

/C03: 橡膠塗層

#### 主要機能及特點

將 R3 系列 I/O 模組增加到 R30 系列模組使用時的安裝基座。  
將此基座連接到 R30BS 進行擴充。R3 系列 I/O 模組可使用的種類和數量受到電源模組和網路模組的限制。請參閱每個模組的規格書和使用說明書。

#### 注意事項

- 安裝在 R30EBS 上的 R3 系列 I/O 模組的內部匯流排通信週期如下:

內部匯流排通信週期 = 6 ms × I/O 模組數量 + 10 ms (主CPU 資料更新周期)

例: 4個 R3 I/O 模組

$$6 \text{ ms} \times 4 + 10 \text{ ms} = 34 \text{ ms}$$

即使將 R30EBS 增設連接到 R30BS, R30 系列的匯流排通信週期也將保持在大約 1 ms。

#### 一般規格

可安裝模組台數:

R30EBS04: I/O 模組, 4 台

R30EBS08: I/O 模組, 8 台

#### 安裝規格

工作溫度: -10 ~ +55°C (14 ~ 131°F)

保存溫度: -20 ~ +65°C (-4 ~ 149°F)

工作濕度: 10 ~ 90 %RH (無結露)

使用周圍環境: 無腐蝕性氣體及嚴重粉塵

安裝: 壁掛或DIN滑軌

重量 (沒有安裝模組時)

R30EBS04: 約 150 g (0.33 lb)

R30EBS08: 約 280 g (0.62 lb)

#### 性能

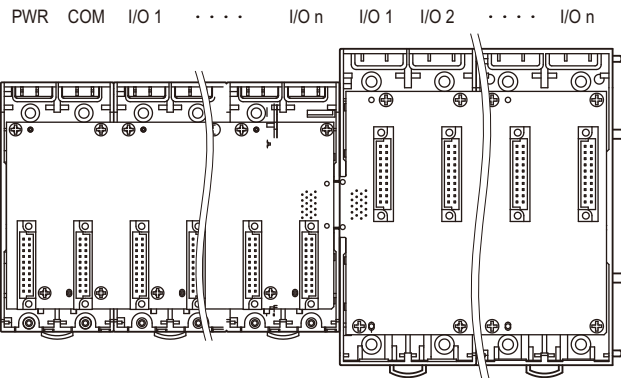
耐電壓: 1500 V AC @1 分鐘

(內部電源或內部通信匯流排- FE 之間;

在電源模組上隔離)

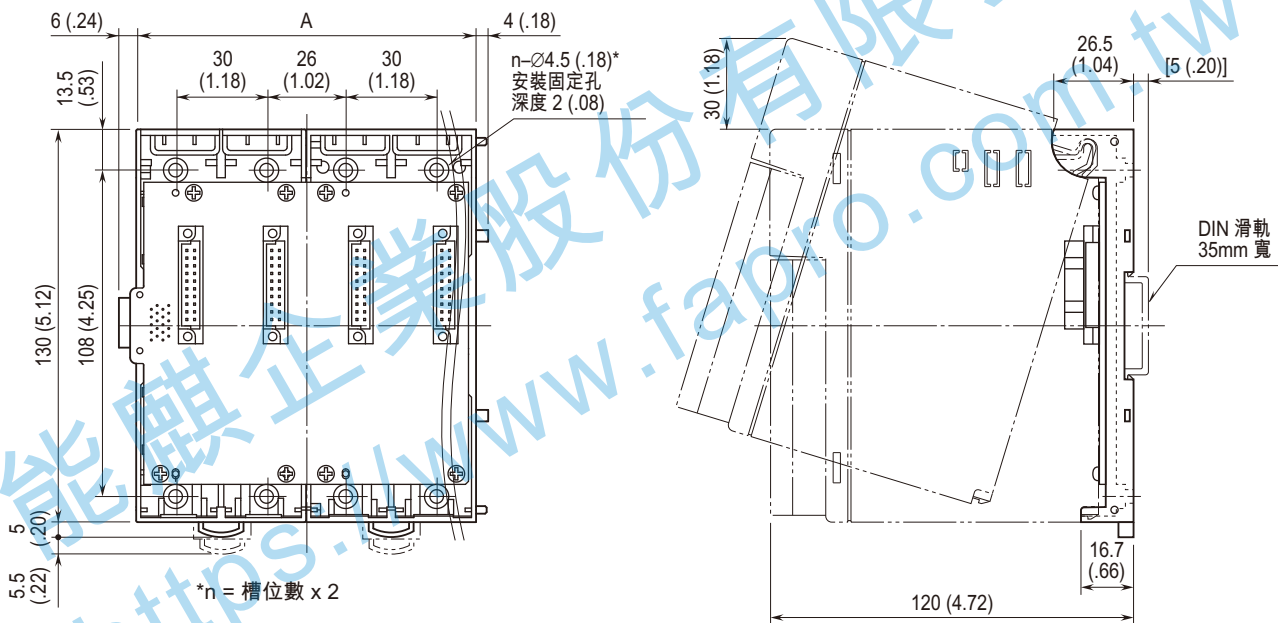
## 外部視圖

與 R30BS 組合使用。請從最左端 (I/O 1) 向右安裝 R3 I/O 模組。



## 外型尺寸圖 單位: mm [inch]

■ R30EBS04, 08

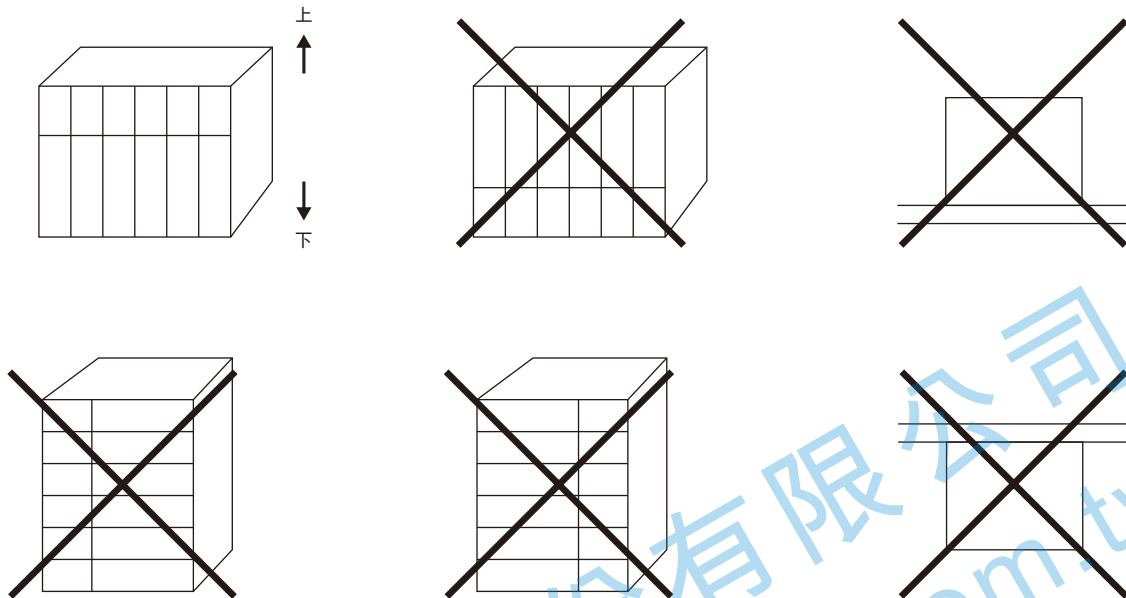


型號	A (尺寸)	(安裝螺釘數量 n)
R30EBS04	112	8
R30EBS08	224	16

## 安裝尺寸圖 單位: mm [inch]

### ■ 安裝方向

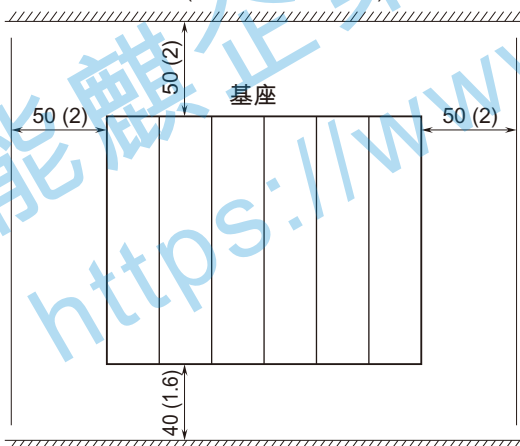
請依下圖所示垂直安裝。若以其它方向安裝可能會導致模組內部溫度上升，從而縮短使用壽命或降低性能。



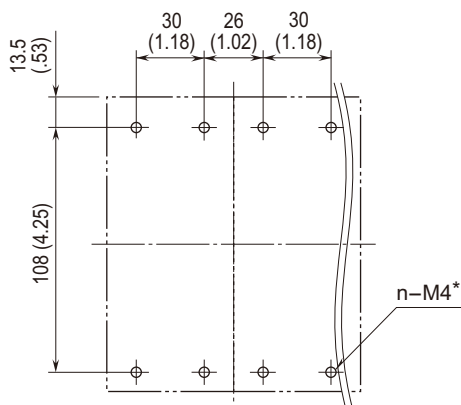
### ■ 安裝在控制盤內

請確保有足夠的通風空間。請勿將裝置安裝在可能產生大量輻射熱的設備上方，例如加熱器、變壓器或電阻器。設備上方和下方也需要保留維護用空間。

控制盤頂部或線槽 (高度 ≤ 50 mm 或 2")



控制盤底部或線槽 (高度 ≤ 50 mm 或 2")



\*n = 槽位數 x 2



規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司  
<https://www.fapro.com.tw>